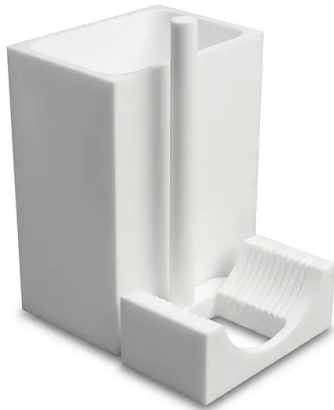


# Panier De Nettoyage Carré Personnalisable En Ptfé Pour Wafers De Silicium, Pour Gravure Par Procédé Humide Semi-Conducteur Et Manipulation De Substrats

Numéro d'article: PL-CP88



## Introduction

Paniers de nettoyage carrés en PTFE de haute pureté conçus pour le traitement de wafers de silicium. Ce support résistant à la corrosion assure une gravure humide et une manipulation de substrats en toute sécurité dans la fabrication de semi-conducteurs. Des dimensions et configurations entièrement personnalisables sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques des bancs humides de laboratoire ou industriels.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Fabrication de semi-conducteurs	Immersion de wafers de silicium dans des solutions de nettoyage RCA ou de gravure Piranha pour éliminer les contaminants.	Risque nul de contamination métallique
Production de cellules photovoltaïques	Manipulation de wafers solaires grand format pendant les étapes de texturation et de polissage par acide.	Débit élevé et durabilité
Traitement de dispositifs MEMS	Transport sécurisé de substrats microélectromécaniques délicats à travers différents bancs humides.	Positionnement précis du substrat
Nettoyage de verre LCD/OLED	Nettoyage de substrats de verre conducteur (ITO/FTO) avant le dépôt de couche mince.	Résistance chimique aux nettoyants pour verre
Recherche de laboratoire haute pureté	Support d'échantillons pendant l'analyse de traces et les procédés de digestion chimique agressive.	Résistance supérieure aux milieux corrosifs
Substrats nanotechnologiques	Traitement de wafers silicium sur isolant (SOI) ou de wafers saphir dans des environnements de recherche.	Manipulation douce des matériaux fragiles

Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP88
Identifiant du modèle	PL-CP88
Matériau principal	Polytétrafluoroéthylène (PTFE) haute pureté
Dimensions standard	249 mm x 249 mm (tailles sur mesure disponibles sur demande)
Géométrie	Conception de panier fleur à cadre carré
Options de personnalisation	Nombre de fentes, largeur de fentes, profondeur de fentes, entrefer et style de poignée
Plage de température de fonctionnement	-200°C à +260°C
Résistance chimique	Universelle (sauf métaux alcalins fondus et fluor haute pression)
Méthode de fabrication	Usinage CNC de précision de bout en bout pour des spécifications à haute tolérance
Finition de surface	Finition fluoropolymère lisse et non poreuse

Application	Description	Avantage clé
Catégorie de spécification	Détails des paramètres pour PL-CP88	

**Compatibilité** Bains d'immersion manuels et bras de banc humide robotisés automatisés